

USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



USB, mint megbízható adat-interfész ipari környezetben használt készülékéhez. A számos előnynek köszönhetően többnyire USB-aljakatokat használnak a villamosenergia-iparban.

Az USB-A, -B - C és -Micro komponensek széles választéka a holnapra kész készülékkonstrukciót tesz lehetővé 10 Gbit/s sebességgel. USB NYÁK aljzataink a robusztus USB 2.0, 3.0 és 3.1 szabványokat támogatják a gyors és könnyű adatátvitel érdekében.

Az egyes csatlakozók a nagy tartósságra vonatkozó követelményeknek is megfelelnek, és megbízható csatlakoztatást biztosítanak.

- Akár 10,000 dugaszolási ciklus
- THT, THR vagy SMD forrasztási eljárások
- 180°-os (függőleges/álló) vagy 90°-os (vízszintes/fekvő) kialakítással kapható
- Tálcsa (TY) vagy tekercses (dobra csévéltekercs, RL) csomagolás
- Megerősített aranyréteg a korrózió elleni hatékonyabb védelemért
- Az USB 3.1 aljakat gyors, akár 10 Gbit/s adatátvitelt is támogatnak.
- Az USB-C aljakat hibamentes dugaszolást tesznek lehetővé a szimmetrikus kialakításnak köszönhetően.
- Megbízható plug & play működés – a rendszer leállítása vagy újraindítása nélkül csatlakoztatható és leválasztható

Általános rendelési adatok

Verzió	OMNIMATE Data - USB csatlakozók, hüvelyes érintkezősor, 480 Mbps, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 180°, ≥ 1500, Osztás, mm (P): 2.00 mm, Pólusszám: 4, LCP, fekete, Tray (manual assembly)
Rendelési szám	2563730000
Típus	USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118572346
Qty.	100 Stück
Csomagolás	Tray (manual assembly)

USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	7,12 mm	Mélység (coll)	0,28 inch
Magasság	19,3 mm	Magasság (coll)	0,76 inch
Legalacsonyabb változat magassága	15 mm	Szélesség	14,5 mm
Szélesség (coll)	0,571 inch	Nettó tömeg	0,001 g

Electrical properties

Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	1,5 A at 250 V AC
Szigetelés erőssége	≥ 1000 MΩ	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	500 V AC

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	LCP	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	II
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 500	Szigetelés erőssége	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező alapanyaga	Foszfor-bronz	Érintkező anyaga	Cu-ötvezet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
Tárolási hőmérséklet, min.	-20 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C

Csomagolás

Csomagolás	Tray (manual assembly)	VPE hosszúság	269 mm
VPE szélesség	241 mm	VPE magasság	13 mm

Rendszerspecifikációk

Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó	Dugaszolási ciklusok	≥ 1500
Dugaszolási erő/pólus, max.	35 N	Felszerelés NYÁK-ra	THT/THR-forrasztott csatlakozással
Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás, Hullámforrasztás	Forrasztótüske hossza (l)	2,9 mm
Forrasztótüske méretei	Nyolcszögletű	Forrasztótüskék száma pólusonként	1
Húzóerő / pólus, max.	10 N	Kimenő könyök	180°
LED	Nem	Osztás, inch (P)	0,079 "
Osztás, mm (P)	2 mm	Pólusszám	4
Shield tabs	none	Teljesítménykategória	480 Mbps
Termékcsalád	OMNIMATE Data - USB csatlakozók	Tolerance of solder pin position	± 0.1 mm
Védelmi osztály	IP20	Árnyékolás	Igen
Árnyékolás felülete	nikkelezett	Árnyékoló anyag	Sárgaréz
Átviteli sebesség	480 Mbps		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9,1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

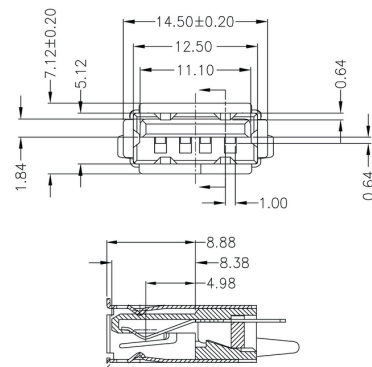
USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

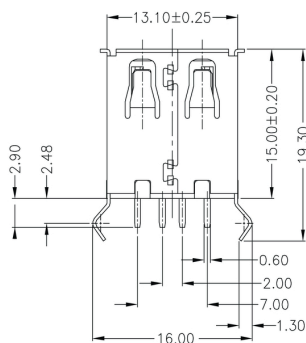
www.weidmueller.com

Rajzok

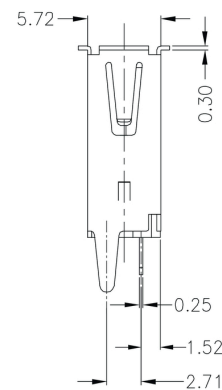
Méretrajz



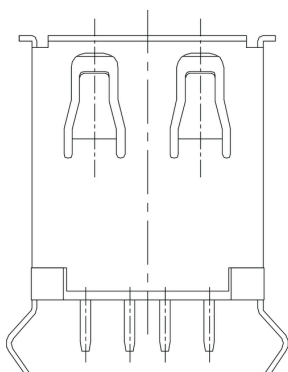
Méretrajz



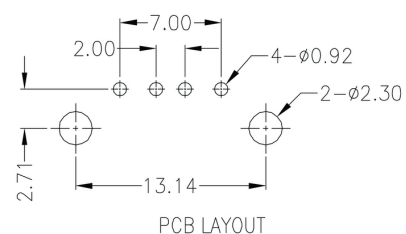
Méretrajz



Méretrajz



NYÁK kivitel



USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Jelmagyarázat

	USB	3.0A	R	I	V	3.0	N	4	TY	BL
										USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL
Colour / Special Option									BL blue (plastic) BK black (plastic) WH white (plastic) SO customized product	
Packaging									TY Tray in box (manual assembly) RL Tape on Reel (automated assembly) TU Tube	
Contact surface thickness									4 1 = 3µr, 2 = 6µr, 3 = 15µr, 4 = 30µr , 5 = 50µr N no use	
Solder Pin length									3.2 3.2 mm 1.6 1.6 mm D SMD	
Direction									H Horizontal (90°, side entry) U Horizontal Upright 90° V Vertical (180°, top entry)	
Number of Ports									1 1 Port 21; 41; ... multi ports about each other, Multilevel	
Assembly on PCB									R Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering S Surface Mount Technology - SMT T Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave	
Type / Performance									2.0A USB 2.0 Type A 3.0A USB 3.0 Type A	

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.